

技术参数

5909Y/G5909Y

日期: 05/30/2016

网址: www.stick1mat.com



上海禧合应用材料有限公司

应用

特点 单组份环氧树脂胶粘剂，固化速度快，加热易返修，适用于 CSP/BGA & SMT 领域的芯片表面包封及拼脚保护

粘接材料 金属，陶器，玻璃，木料

典型应用 CSP/BGA & SMT 芯片拼脚及电容器保护

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂胶粘剂	
外观	浅黄色液体	
粘度	3687 cps	20rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件*	2min@150°C;	
比重	1.05 g/ml	ASTM D-1875

*固化温度是指固化时胶水本身达到的温度。

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	淡琥珀色固体	
邵氏硬度	65D	ASTM D-2240
玻璃化温度	50.23°C	DSC, TA Q20, 40°C/MIN
搭接剪切强度	NA	Al to Al
降解温度	322°C	10% 重量损失
吸水率	1%	ASTM D 570-98
工作温度范围	-55°C—150°C	

储运条件

使用方法 点胶，浸蘸，滚涂；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。

储存方法 <-5°C，冷冻保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 包装至少解冻2 小时，55ml 包装及以上大包装需要解冻更长时间至少解冻4 小时；

有效期 6 个月

包装

30ml 针筒装，55ml 针筒装，

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的任何问题我们无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。